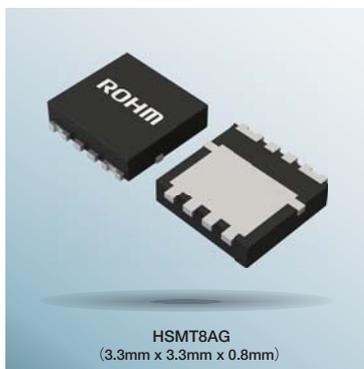


支持车载 小型封装Nch 40V MOSFET AG009DGQ3



支持车载 (AEC-Q101标准) 实现小型尺寸!

产品概要

车载电装用途中增加整机的附加功能将随之增加MOSFET数量, 为确保整机尺寸, 不断向小型封装快速发展。以往的车载电装用MOSFET为了维持品质, 以5mm x 6mm尺寸封装为主, AG009DGQ3不仅具备大功率, 还保证车载品质, 实现了3.3mm x 3.3mm小型尺寸。

■ 高贴装可靠性, 具有车载品质

采用独有的引脚结构, 提高具有致命风险的栅极引脚的焊接品质, 确保了车载品质。

一般封装

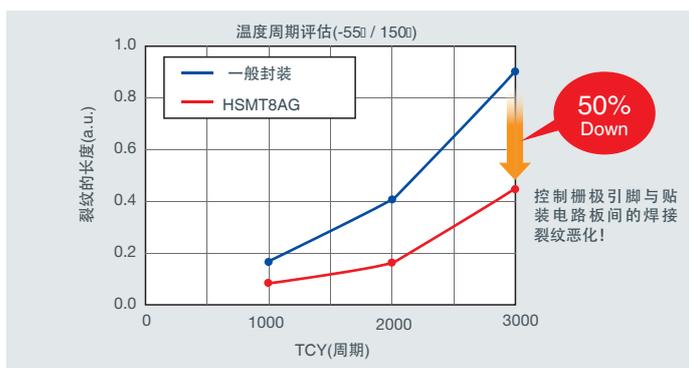
电镀

电镀

HSMT8AG封装

扩大引脚宽度, 提高贴装性能
栅极引脚面积为以往的2倍, 提高接合强度!

通过中央电镀处理,
提高焊料润湿性
栅极引脚的中央部也已实施电镀处理



■ 比以往贴装面积减少64%

SOP8
6.0mm x 5.0mm
PD=20W(TC=25°C)

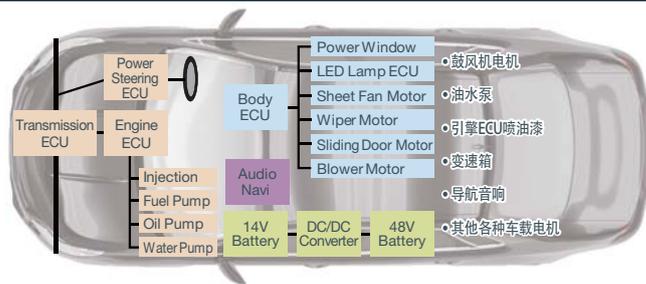
HSOP8
6.0mm x 5.0mm
PD=130W(TC=25°C)

贴装面积减少
64%

HSMT8AG
3.3mm x 3.3mm
PD=75W(TC=25°C)

保持大功率的同时, 比以往贴装面积减少64%。

■ 适用于车载应用



■ 主要特性

型号	AG009DGQ3	
极性	Nch	
漏源电压 V_{DSS}	40V	
漏极电流 I_D	$\pm 30A$	
额定容许损耗 P_D	75W	
保存温度 T_{stg}	$-55 \sim 175^\circ C$	
漏极源极间导通电阻 $R_{DS(ON)}$	6.0m Ω (Typ.)	$V_{GS}=10V$ $I_D=30A$
	8.0m Ω (Max.)	
	7.3m Ω (Typ.)	$V_{GS}=4.5V$ $I_D=15A$
	10.0m Ω (Max.)	
栅极总电荷量 Q_g	32.0nC (Typ.)	$V_{GS}=10V$ $V_{DD}=20V$ $I_D=15A$
	15.0nC (Typ.)	$V_{GS}=4.5V$ $V_{DD}=20V$ $I_D=15A$

本资料所记载的内容只是产品的情况介绍。要使用该产品时, 请务必通过别的途径获取规格说明书, 进一步确认产品的规格及其性能。本资料所记载的内容是力求准确无误而慎重编制成的, 但万一用户方出现因该内容存在错误或打字差错造成损失的情况, 罗姆公司不予承担责任。本资料所介绍的技术内容是产品的典型工作状况和应用电路举例等, 对于罗姆或其他公司的知识产权及其他所有权利未做明确的、暗示的准予实施或使用的承诺。如因使用这些技术内容而引发纠纷, 罗姆公司不予承担责任。在出口本资料所介绍的产品及技术中符合「外汇及外国贸易法」的产品或技术时, 或者向国外提供时, 必需取得依照该法发放的许可。

本资料所记载的内容是截至2016年09月13日的材料。
Catalog No.59F7024C-A 2016.09 ROHM ©